

Job Description

(Date : 2021. 04. 06)

직무명	정밀가공기술	소속	삼성전자 글로벌기술센터
근무부서	요소기술팀 공정개발그룹 가공기술파트		
부서 업무소개	팀: 미래 대비 제품 및 제조 분야 신기술 개발 및 사업부 기술 지원		
	그룹: 전사 기구 부품의 제조 공정을 위한 소재/공정 기술 개발		
	파트: 금속/Polymer/Glass/복합재료 기구부품의 가공기술 개발		
부서 멘토	성명:이군표 CL3	이메일: huse4477.lee@samsung.com	
요구사항	- 가공 공정 학술 지식 보유 (1 항목 이상) 1) 절삭/연삭/폴리싱 메커니즘 2) 특수가공 (방전가공, 전해가공) 3) Toolpath planning/Motion control - 가공공정 실험 시스템 구현 및 실험 경험 보유 必		
주요 업무내용	- 당사 제품에 특화된 절삭/연삭/폴리싱/특수가공 공정 설계 . Process planning, DFM, CAM/Motion Planning, Tool Design, Machine mechanism, Jig/Fixture, Machining physics - 가공 생산라인 개발 및 양산성 향상 기술 적용 - 신소재 가공법 및 당사 제품 向 신규 공법 개발		
단기 업무계획 (2년 이내)	- 당사 전략 제품의 가공부품 양산 기술 개발 . Metal, Glass, Ceramics, PCB, TFT Glass 등		
중장기 업무계획 (2년 이후)	- New Form Factor 대응을 위한 가공기술 확보 . 난삭소재의 고효율/고품질 가공 기술 . 복잡형상 가공을 위한 가공 메커니즘 개발 - Intelligent Machining 기술 . On-Machine Measurement 기술 고도화를 위한 알고리즘 개발 . 설비 內 자동 Motion planning 및 생산 품질 Tracking/예측		
연락처	부서	변정원 CL4 (jungwon.byun@samsung.com , +82-10-4722-8893)	
	인사	글로벌기술센터 인사그룹 (gtchr.sec@samsung.com , +82-31-200-2460)	